

[会員限定] 2024年度第2回 WBG実装WG研究会

【開催日】2024年8月23日(金)14:00～19:15

【会場】大阪大学 吹田キャンパス 銀杏会館 3F大会議室

大阪大学産業科学研究所F3D協働研究所研究所におけるF3D実装コンソーシアム活動におきまして、2024年度期における当該コンソーシアム活動傘下のWBG実装WG (WGB-WG)研究会を下記の内容で開催いたします。会場URL: <https://www.med.osaka-u.ac.jp/icho/accessmap>

【プログラム】 【次世代パワーモジュール実装材料と信頼性評価】

14:00-14:10 開会挨拶

ハイブリッド開催
(阪大産研+ZOOM)

14:10-15:00 講演①

「次世代パワーモジュールパッケージングに適用するセミックス基板の製造、特性および課題（仮題）」

デンカ株式会社 電子先端プロダクツ部門／インフラソリューション部門
セラミックス研究部 グループリーダー 岩切 翔二 氏

15:00-15:50 講演②

「宇宙機および車載用パワエレ機器・デバイスの絶縁材料における劣化現象と信頼性評価（仮題）」

三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 電機システム技術部
電気絶縁技術グループ 宮路 仁崇 氏

15:50-16:10 休憩・講師との名刺交換会

16:10-17:00 講演③

「次世代パワーデバイスのパワーサイクル試験と過渡熱抵抗測定（仮題）」

株式会社ケミトックス PWB/デバイス信頼性評価事業部

マネジャー パワーデバイス評価プロフェッショナル 須藤 正

17:15-19:15 講演者を交えた意見交換会

お申込みは
こちらから！



<https://docs.google.com/forms/d/1Pd2PUr6biXoBIR5F2dXMyFGnwqp05Um23jP-ShIN-CQ/edit>

会場アクセス Web: <https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/access/>

申し込み・問い合わせ 大阪大学 産業科学研究所 F3D実装協働研究所 WBG-WG事務局

(TEL/FAX: 06-6879-4295/E-mail: hikita.masayuki@sanken.osaka-u.ac.jp) 匹田 政幸

主催：大阪大学 産業科学研究所 F3D実装協働研究所

後援：一般財団法人大阪大学産業科学研究協会